和晶科技 —— 成功完成发行股份购买资产并募集配套资金项目

2023年10月24日，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）顺利完成发行股份购买资产并募集配套资金项目，募集配套资金4,750万元，本次发行的股票将于近期在深交所创业板上市。

本次交易的对价为2.59亿元，已于2022年12月完成资产交割及向标的公司（和晶智能，现为公司全资子公司）原股东安徽新材料基金、淮北中小基金、淮北盛大建投的股份支付登记上市。本次公司募集配套资金的发行，参与认购报价的投资者踊跃度高，最终整体认购倍数达6.23倍，充分体现了投资者对公司长期投资价值的高度认可。随着本次募集配套资金的股份发行工作顺利实施，公司本次交易中的股权融资即将圆满完成，亦为公司的整体战略发展提供了良好的资本助力。

公司以智能制造、智能化工程建设为基石，以智慧安全平台与应用开发运营、智慧城市综合应用解决方案为发展动力，构成涵盖物联网云计算、IoT制造、智慧城市应用、智慧业务集成、平台运营为一体的业务群。公司以突出的研发与制造缔造行业口碑，坚持高端、智能化、节能环保，基于在智能控制器领域二十多年来的耕耘和经验积累，形成了稳定、高效和大规模的制造能力。在家电领域，公司业务已涵盖亚、欧、北美市场，连续多年获海尔、美的等全球顶尖品牌的优秀模块商、供应商年会精诚奖等荣誉；在汽车电子领域，公司的车用各类传感器、控制器等已间接供货宁德时代、特斯拉、大众等国内外整车和配套企业，未来计划进一步扩大在汽车电子的业务范围及规模。

此次发行股份购买资产并募集配套资金项目，在东方证券承销保荐有限公司、北京天驰君泰律师事务所、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）的专业能力和优质服务提供下顺利完成。我们期待在未来的发展中，继续得到各方的支持和帮助，为行业的高质量发展贡献力量。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/205868.html